

リードフレーム処理

リードフレームの為のワイヤーボンディングの前のプラズマ洗浄



用途

表面の不純物の状態は、ボンドパッドとワイヤーとの間の接着に極めて重要な影響を及ぼします。ボンドコンタクトと接着強度を最大にする事とその品質は、ボンドパッドの最終的な清浄度と相関があります。低压プラズマによる処理条件は、必要とされる清浄度レベルに因ります。大抵のアプローチに対して、特にリードフレームの入った容器を処理するケースでは、旨く処理が出来ます。

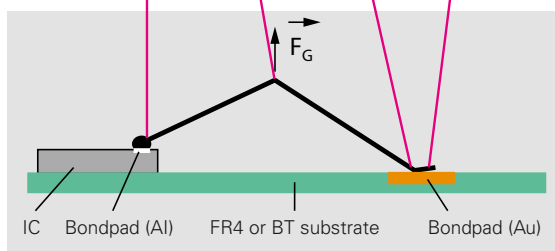
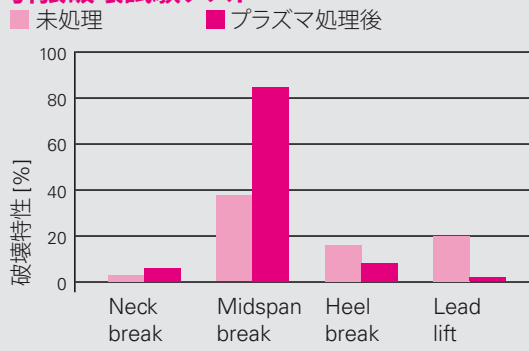
プラズマプロセス

有機物残渣については、乾式で且つ低温でのプラズマの化学反応によって、極少量のガス組成物として除去が可能です。接着強度(品質)は、劇的に改善されます(図を参照)。リードフレーム上の金属酸化物の様な想定外の組成物による影響を避ける事も、プロセスエンジニアリングにより解決できます。

装置

プラズマは、真空チャンバー内に純度の高い少量のガスを入れて、マイクロ波を発生させる事で生成されます。処理温度による影響を最小限にしながら、マガジン内のリードフレームを旨く処理できる事が、マイクロ波プラズマの特徴となります。V80-Gは、リードフレームの洗浄プロセスに応用される低压プラズマシステムの最適な機種となります。プラズマシステムは、自動化を含む様々な要求に対してカスタマイズが可能です。

引張破壊試験テスト



プラズマ洗浄によって、破壊特性(破断部分)に関しては、ボンドパッドからワイヤー部分に移ります(テスト方法は、MIL-STD 883Dに因ります)

ピンクジャパン株式会社

〒105-0004
東京都港区新橋 5-25-3
第2-松ビル 1F
電話(オフィス)：03-5777-0602
ファックス：03-5777-0604
info@pink-japan.co.jp
www.pink-japan.co.jp

PiNK GmbH Thermosysteme

Am Kessler 6
97877 Wertheim, Germany
T +49 (0) 93 42 919-0
F +49 (0) 93 42 919-111
plasma@pink.de
www.pink.de



V80-Gユニットは、ワイヤーボンディング前のリードフレームのプラズマ洗浄プロセスに対して非常に適しています。